

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 3 区分

【発行日】平成20年3月27日(2008.3.27)

【公開番号】特開2002-304611(P2002-304611A)

【公開日】平成14年10月18日(2002.10.18)

【出願番号】特願2001-104761(P2001-104761)

【国際特許分類】

G 0 6 K 19/077 (2006.01)

B 4 2 D 15/10 (2006.01)

C 0 8 J 5/18 (2006.01)

C 0 8 K 3/00 (2006.01)

C 0 8 L 101/00 (2006.01)

C 0 9 J 7/02 (2006.01)

G 0 6 K 19/07 (2006.01)

C 0 8 J 9/00 (2006.01)

【 F I 】

G 0 6 K 19/00 K

B 4 2 D 15/10 5 2 1

C 0 8 J 5/18 C E S

C 0 8 J 5/18 C F D

C 0 8 K 3/00

C 0 8 L 101/00

C 0 9 J 7/02 Z

G 0 6 K 19/00 H

C 0 8 J 9/00 A

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月8日(2008.2.8)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 厚さ 40 ~ 1,000 μm の熱可塑性樹脂フィルム (A) の表面に、アンテナ (C)、および IC 回路 (D) を有する回路受理層 (B) を保持する IC タグ用シートであって、該回路受理層 (B) が熱可塑性樹脂および無機フィラーから構成された塗料を塗工、乾燥硬化する方法で設けた厚さが 5 ~ 100 μm であり、空隙率が 20 ~ 70 % であり、該アンテナ (C) を加熱加圧しながら該回路受理層 (B) に設置することを特徴とする IC タグ用シート。

【請求項 2】 回路受理層 (B) が、無機フィラー / 熱可塑性樹脂の重量比率が 0.2 ~ 11.5 であることを特徴とする請求項 1 に記載の IC タグ用シート。

【請求項 3】 熱可塑性樹脂フィルム (A) に用いられる熱可塑性樹脂が、ポリオレフィン系樹脂またはポリエステル系樹脂であることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の IC タグ用シート。

【請求項 4】 ポリオレフィン系樹脂が、プロピレン系樹脂であることを特徴とする請求項 3 に記載の IC タグ用シート。

【請求項 5】 熱可塑性樹脂フィルム (A) の空孔率が 5 ~ 60 % であることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の IC タグ用シート。

【請求項 6】 熱可塑性樹脂フィルム（Ａ）の裏面に粘着剤層をもつことを特徴とする請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載のＩＣタグ用シート。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００４

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００４】

【課題を解決するための手段】

本発明は、特定の積層構成を規定し、その表面にアンテナ回路とＩＣ回路を直接設置して設けた、安価なＩＣタグ用の芯材を実現するものである。

すなわち、本発明は、厚さ 40 ～ 1,000 μm の熱可塑性樹脂フィルム（Ａ）の表面に、アンテナ（Ｃ）、およびＩＣ回路（Ｄ）を有する回路受理層（Ｂ）を保持する ＩＣタグ用シートであって、該回路受理層（Ｂ）が熱可塑性樹脂および無機フィラーから構成された塗料を塗工、乾燥硬化する方法で設けた厚さが 5 ～ 100 μm であり、空隙率が 20 ～ 70 % であり、該アンテナ（Ｃ）を加熱加圧しながら該回路受理層（Ｂ）に設置すること を特徴とするＩＣタグ用シートを提供する。

本発明の好ましい実施形態では、回路受理層（Ｂ）が、無機フィラー / 熱可塑性樹脂の重量比率が 0.2 ～ 11.5 であることが好ましい。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００５】

熱可塑性樹脂フィルム（Ａ）に用いられる熱可塑性樹脂が、ポリオレフィン系樹脂またはポリエステル系樹脂であることが好ましい。

ポリオレフィン系樹脂が、プロピレン系樹脂であることが好ましい。

熱可塑性樹脂フィルム（Ａ）が、その空孔率が 5 ～ 60 % であることが好ましい。

また、熱可塑性樹脂フィルム（Ａ）の裏面に粘着剤層をもつこともできる。